

# H8S/Tiny H8S/2400 E100 エミュレータソフトウェア

## V.2.00 Release 00

RJJ10J2248-0200

Rev.2.00

2010.07.16

## リリースノート

弊社製品をご使用いただき厚く御礼申し上げます。本製品を使用するにあたり注意事項がございます。ご留意いただけますようお願い申し上げます。

なお、ルネサス統合開発環境 High-performance Embedded Workshop の注意事項については「High-performance Embedded Workshop リリースノート」に記載していますので、こちらも合わせてご覧ください。

### 目次

1. 対応MCUユニットとターゲットマイコン .....	2
2. バージョンアップ内容 .....	2
2.1 エミュレータソフトウェアのバージョンアップ .....	2
2.2 サポートMCUの追加 .....	2
2.3 注意事項の改修 .....	3
2.4 統合開発環境High-performance Embedded Workshopのアップデート .....	3
3. 注意事項 .....	3
3.1 H8S/Tiny H8S/2400 E100 エミュレータソフトウェアのインストールについて .....	3
3.2 H8S/2400 デバイス選択時、RAME、EXPEビット(*3)設定により変動するエリアに対するソフトウェアブレーク機能の制限について .....	3
4. リアルタイムOS対応デバッグ機能について .....	3
5. 動作環境 .....	4

## 1. 対応 MCU ユニットとターゲットマイコン

H8S/Tiny H8S/2400 E100 エミュレータソフトウェアで対応する MCU ユニットとターゲットマイコンを以下に示します。

表 1.1 対応 MCU ユニットとターゲットマイコン一覧

MCU ユニット名	ターゲットマイコン		
	シリーズ名	グループ名	MCU 型名 *1 *2
ROE420000MCU00	H8S/Tiny	H8S/20103	R4F20102, R4F20103
		H8S/20115	R4F20114, R4F20115
		H8S/20203	R4F20202, R4F20203
		H8S/20215	R4F20214, R4F20215
		H8S/20223	R4F20222, R4F20223
		H8S/20235	R4F20234, R4F20235
ROE424270MCU00	H8S/2400	H8S/2425	R4F24255, R4F24256, R4F24258, R4F24259
		H8S/2427	R4F24275, R4F24276, R4F24278, R4F24279
		H8S/2427R	R4F24275R, R4F24276R, R4F24278R, R4F24279R

\*1 : H8S/Tiny シリーズの MCU 型名は、[デバイスセッティング]ダイアログボックスの

[ターゲットマイコン]ドロップダウンリストボックスで選択できる MCU 型名と同じです。

\*2 : H8S/2400 シリーズの[デバイスセッティング]ダイアログボックスの[ターゲットマイコン]

ドロップダウンリストボックスで選択できる MCU 型名は、” MCU 型名\_ピン数” で表示しています。

## 2. バージョンアップ内容

### 2.1 エミュレータソフトウェアのバージョンアップ

H8S/Tiny E100 エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00 を H8S/Tiny H8S/2400 E100 エミュレータソフトウェア V.2.00 Release 00 にバージョンアップしました。

本バージョンアップに際して、エミュレータソフトウェア名を上記のとおり変更しました。

### 2.2 サポート MCU の追加

デバッグ対象 MCU として、以下の MCU を新たに追加しました。

—H8S/2400 シリーズ

H8S/2425 グループ : R4F24255, R4F24256, R4F24258 および R4F24259

H8S/2427 グループ : R4F24275, R4F24276, R4F24278 および R4F24279

H8S/2427R グループ : R4F24275R, R4F24276R, R4F24278R および R4F24279R

## 2.3 注意事項の改修

ツールニュースでお知らせした次の注意事項を改修しました。

ユーザプログラムが予期しない箇所でブレイクする注意事項。

詳細は、以下の URL で Renesas Tool News 資料番号 100616/tn5 を参考ください。

<http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/100616/tn5.htm>

## 2.4 統合開発環境 High-performance Embedded Workshop のアップデート

同梱の High-performance Embedded Workshop を V. 4. 06. 00 から V. 4. 07. 01 へアップデートしました。

## 3. 注意事項

### 3.1 H8S/Tiny H8S/2400 E100 エミュレータソフトウェアのインストールについて

H8S/Tiny H8S/2400 E100 エミュレータソフトウェア V. 2. 00 Release 00 のインストーラは、

High-performance Embedded Workshop V. 4. 07. 01 を同梱しています。

H8S/Tiny H8S/2400 E100 エミュレータソフトウェア V. 2. 00 Release 00 をインストールすると、

High-performance Embedded Workshop V. 4. 07. 00 以前のバージョンがインストールされている環境では、

V. 4. 07. 01 にリビジョンアップされます。

### 3.2 H8S/2400 デバイス選択時、RAME、EXPE ビット(\*3)設定により変動するエリアに対するソフトウェアブレイク機能の制限について

[制限事項]

ユーザプログラム実行中は、ソフトウェアブレイクポイントの設定・解除を行わないでください。

もしも、プログラム実行中にソフトウェアブレイクポイントの設定・解除を行った場合、予期しない

箇所でユーザプログラムがブレイクする可能性があります。なお、この症状が発生した場合、

ステータスバーのブレイク要因を表示するエリアには、Unknown break cause が表示されます。

[対処方法]

・ユーザプログラム実行中は、ハードウェアブレイクをご使用ください。

・ソフトウェアブレイクを使用する場合は、ユーザプログラム停止中にソフトウェアブレイクポイントの設定・解除を行ってください。

\*3 MCU のシステムコントロールレジスタに割り当てられているビットです。

## 4. リアルタイム OS 対応デバッグ機能について

リアルタイム OS 対応デバッグ機能の詳細については以下をご参照ください。

<http://japan.renesas.com/ecxos>

## 5. 動作環境

表 5.1 動作環境 (Windows® XP、Windows® 2000)

PC 環境	
PC 本体	IBM PC/AT 互換機
OS	Windows® XP 32 ビット版 *4 Windows® 2000
CPU	Pentium 4 1.6GHz 以上を推奨
インタフェース	USB2.0
メモリ	768MB 以上 (+ロードモジュールのファイルサイズの 10 倍以上) を推奨
ハードディスク	エミュレータデバッガのインストールに 200MB 以上の空き容量が必要 (スワップ領域を考慮して、さらにメモリ容量の 2 倍以上(推奨 4 倍以上) の空き容量をご用意ください)
ディスプレイ解像度	1024×768 以上を推奨

\*4 : 64 ビット版の Windows® XP には対応していません。

表 5.2 動作環境 (Windows Vista®)

PC 環境	
PC 本体	IBM PC/AT 互換機
OS	Windows Vista® 32 ビット版 *5
CPU	Pentium 4 3GHz または Core 2 Duo 1GHz 以上を推奨
インタフェース	USB2.0
メモリ	1.5GB 以上 (+ロードモジュールのファイルサイズの 10 倍以上) を推奨
ハードディスク	エミュレータデバッガのインストールに 200MB 以上の空き容量が必要 (スワップ領域を考慮して、さらにメモリ容量の 2 倍以上(推奨 4 倍以上) の空き容量をご用意ください)
ディスプレイ解像度	1024×768 以上を推奨

\*5 : 64 ビット版の Windows Vista® には対応していません。

以上

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事情報の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



ルネサスエレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2（日本ビル）

(03)5201-5307

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。  
総合お問合せ窓口：<http://japan.renesas.com/inquiry>